

Bienvenido a O-Leading

O-Leading se esfuerza por ser su socio de solución integral en la cadena de suministro de EMS, incluido el diseño de PCB, la fabricación de PCB y el ensamblaje de PCB (PCBA). Proporcionamos algunas de las tecnologías de PCB más avanzadas, incluyendo PCB de HDI, PCB de múltiples capas, PCB rígido-flexibles. Podemos apoyar desde el prototipo de giro rápido hasta la producción media y en masa.

En general, nuestros clientes globales están muy impresionados con nuestros servicios: respuesta rápida, precio competitivo y compromiso de calidad. Brindar un servicio técnico más valioso y una solución general es la forma en que O-lidera.

Mirando hacia el futuro, O-Leading se concentrará en la innovación y el desarrollo de la tecnología de fabricación de productos electrónicos como siempre, y realizará esfuerzos persistentes en el servicio integral de PCB y PCBA para proporcionar servicios de primera clase y crear más valor para nuestros clientes.

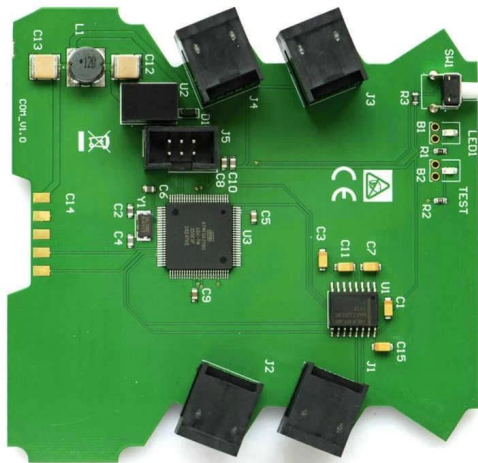
HAGA CLIC EN ESTOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: [Los productos de PCB se utilizan en productos electrónicos industriales](#)

Descripción del producto

BOM

Manufacturer	Manufacturer Part Number	Designator (required)	Qty (required)	Description (required)	Case
Panasonic	ERJ-3GEYJ331V	R2	1	Thick Film Resistors 0603 330ohms 5% AEC-Q200	0603
Panasonic	ERJ-6GEYJ103V	R3	1	Thick Film Resistors 0805 10Kohms 5% AEC-Q200	0805
Vishay	CRCW06031K00FKEAC	R1	1	Thick Film Resistors - SMD 1/10Watt 1Kohms 1% Commercial Use	0603
ON Semiconductor	SZMM5Z4690T3G	D1	1	5.6 V Low Current Zener Diode Voltage Regulator	SOD-123-2
TDK	CGA9N3X7S2A106K230KB	C12,C13	2	10µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7S 2220 (5750 Metric)	2220
KEMET	T491A105K016AT7280	C1, C3, C7, C11, C15	5	1µF Molded Tantalum Capacitors 16V 1206 (3216 Metric) 10Ohm	1206
KEMET	C0805J104K5RACAUTO	C5, C8, C9, C10	4	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 0.1uF 10% X7R AUTO	0805
KEMET	C0805C220J4GACTU	C2,C4,C6	3	Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V 22pF COG 0805 0.05	0805

O-LEADING
TOP BY INNOVATION TOP BY SUPPORT



**Recom Switching
Regulator,
8 42V Input,
5V Output, 1A**

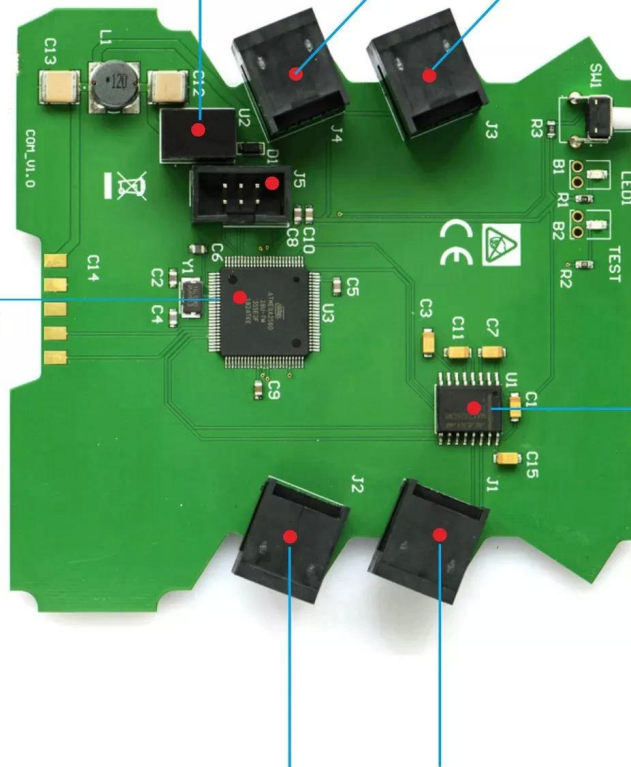
**Jack Modular Connector 8p8c
(RJ45, Ethernet) 90° Angle
(Right) Unshielded**

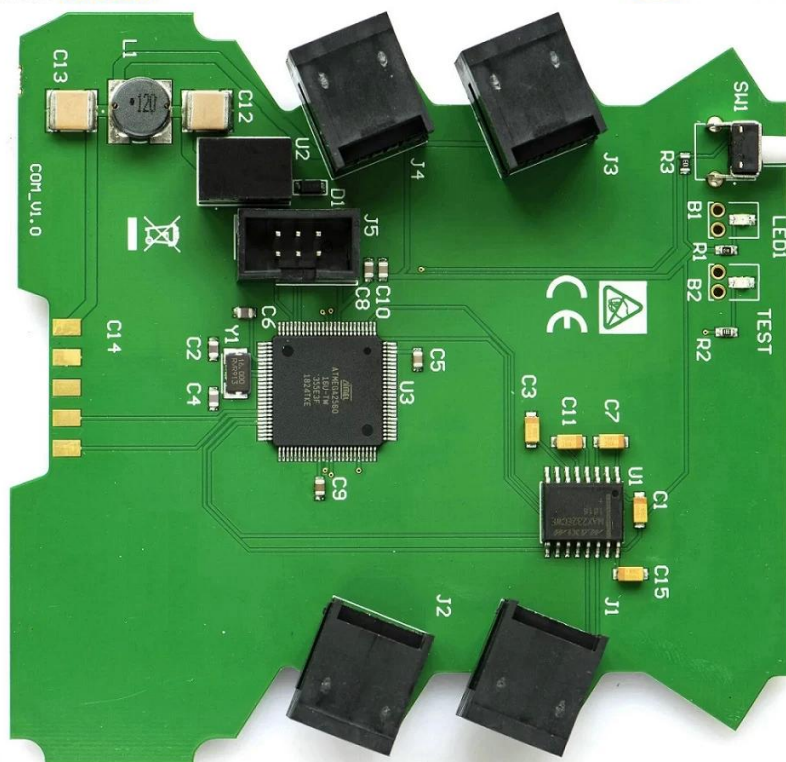
O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

**Atmega
2560-16AU**

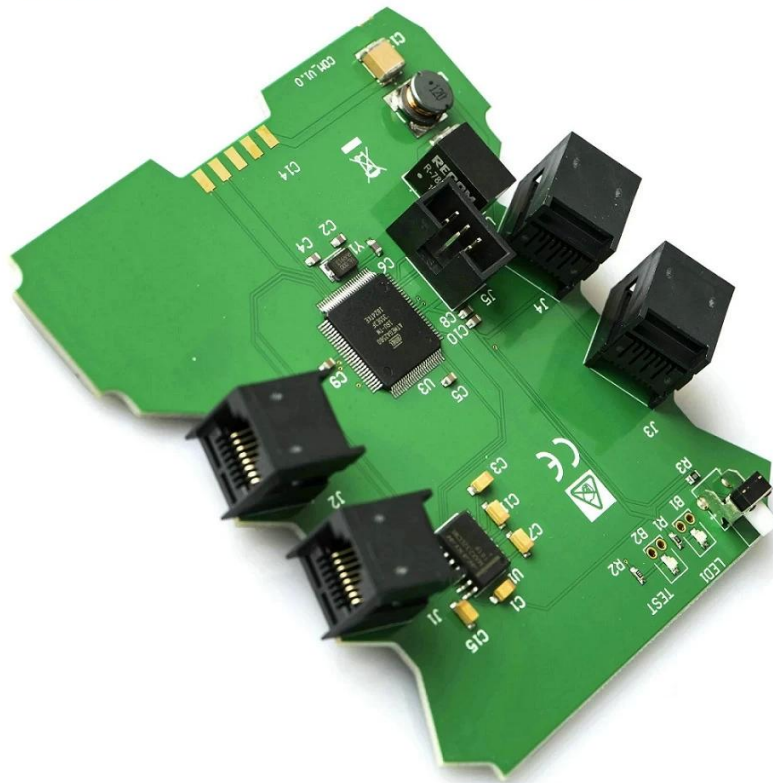
**IC TRANSCEIVER
FULL 2/2 16SOIC**

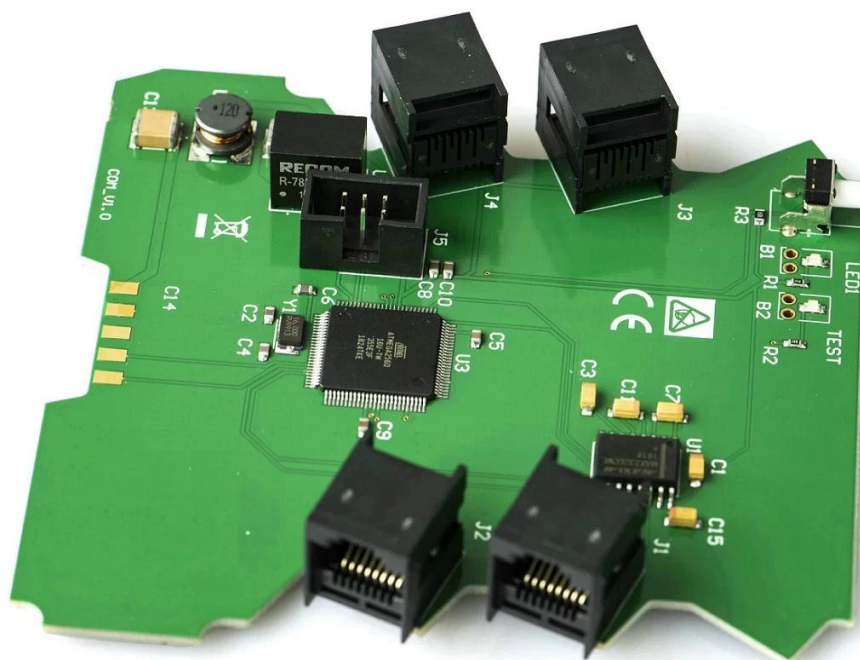
**Jack Modular Connector 8p8c
(RJ45, Ethernet) 90° Angle
(Right) Unshielded**











www.o-leading.com



Nuestro equipo



[Golden Fingers PCB fabricante china](#)

Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Certificaciones





Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 1 of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

1313.FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : RP19-005089 - SZ

Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period : 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Requested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method : Please refer to next page(s).

Test Results : Please refer to next page(s).

Conclusion : Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina Fan
Approved Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, the Company's sole responsibility is to the Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

For more information, please contact our sales representative. Please contact us at telephone: (86-755) 8307 1442 or email: CHN.Sales@sgs.com
SGS (Shenzhen) Co., Ltd. (Shenzhen) Sales Representative (Shenzhen) 5181201 (86-755) 8308888 (86-755) 83106190 www.sgs.com or www.cn.sgs.com
中国·深圳·龙岗区政府后街430号工业园4楼405室 邮编: 5181201 (86-755) 8308888 (86-755) 83106190 e: sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	SZX19-005304.001	Green"PCB"

Remarks :

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test item(s)	Limit	Unit	MDL	Q/Z
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	8
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any, the Company's sole responsibility is to the Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

For more information, please contact our sales representative. Please contact us at telephone: (86-755) 8307 1442 or email: CHN.Sales@sgs.com
SGS (Shenzhen) Co., Ltd. (Shenzhen) Sales Representative (Shenzhen) 5181201 (86-755) 8308888 (86-755) 83106190 www.sgs.com or www.cn.sgs.com
中国·深圳·龙岗区政府后街430号工业园4楼405室 邮编: 5181201 (86-755) 8308888 (86-755) 83106190 e: sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Solder Limits C	Oper Temp C	Flame Class	Meets UL796 DSR	C T I
	Min	Min			Area	Area						
	mm(in)	mm(in)			Diam	sec						
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-	
Multilayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-	
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All		
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-	
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-	
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*	
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*	

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Capacidad de procesamiento

Capacidades de producción de PCB		Capacidades de producción SMT	
Recuento de capas	1Layer-32Layer	Material de PCB	FR-4, CEM-1, CEM-3, tablero a base de aluminio
Espesor de cobre terminado	1 / 3oz-12oz		
Ancho mínimo de línea / espaciado interno	3.0mil / 3.0mil	Tamaño máximo de PCB	510x460mm
Ancho mínimo de línea / espaciado externo	4.0mil / 4.0mil	Tamaño mínimo de PCB	50x50mm
Relación de aspecto máx.	10: 1	Espesor de PCB	0.5mm-4.5mm
Espesor del tablero	0.2mm-5.0mm	Espesor del tablero	0.5-4mm
Tamaño máximo del panel (pulgadas)	635 * 1500 mm	Tamaño mínimo de componentes	0201
Tamaño mínimo del orificio perforado	4mil	Componente de tamaño de chip estándar	0603 y más grande
Tolerancia de agujeros revestidos	+/- 3mil	Componente altura máxima	15mm
Blind / Vías enterradas (tipos All)	SI	Paso de plomo mínimo	0.3mm
Vía relleno (conductivo, no conductivo)	SI	Paso mínimo de pelota BGA	0.4mm
Material de base	FR-4, FR-4 de alta Tg. Material libre de halógenos, Rogers, Base de aluminio, Poliimida, cobre pesado	Precisión de colocación	+/- 0.03mm
Acabados superficiales	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, plata de inmersión, Inmersión de estaño, dedos dorados, tinta de carbono		

Empaquetado y entrega

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo O-Leading garantiza la calidad?

Nuestro estándar de alta calidad se logra con lo siguiente.

- 1.1 El proceso está estrictamente controlado bajo las normas ISO 9001: 2008.
- 1.2 Uso extenso de software en la gestión del proceso de producción.
- 1.3 Equipos y herramientas de prueba de última generación. P.ej. Sonda de vuelo, inspección de rayos X, AOI (Inspector óptico automatizado) y ICT (prueba en circuito).
- 1.4 Equipo de aseguramiento de calidad dedicado con proceso de análisis de casos de fallas
- 1.5 Formación y educación continua del personal.

2. ¿Cómo O-Leading mantiene su precio competitivo?

Durante la última década, los precios de muchas materias primas (por ejemplo, cobre, productos químicos) se duplicaron, triplicaron o cuadruplicaron; La moneda china RMB se había apreciado un 31% sobre el dólar estadounidense; Y nuestro costo laboral también aumentó significativamente. Sin embargo, O-Leading ha mantenido nuestros precios estables. Esto se debe completamente a nuestras innovaciones para reducir costos, evitar desperdicios y mejorar la eficiencia. Nuestros precios son muy competitivos en la industria con el mismo nivel de calidad. Creemos en una asociación de beneficio mutuo con nuestros clientes. Nuestra asociación será mutuamente beneficiosa si podemos proporcionarle un costo y calidad de vanguardia.

3. ¿Qué tipo de tableros puede procesar O-Leading?

Tableros comunes FR4, alto TG y libres de halógenos, Rogers, Arlon, Telfon, tableros a base de aluminio / cobre, PI, etc.

4. ¿Qué datos se necesitan para la producción de PCB y PCBA?

4.1 Lista de materiales (BOM) con designadores de referencia: descripción del componente, nombre del fabricante y número de pieza.

4.2 Archivos de PCB Gerber.

4.3 Dibujo de fabricación de PCB y dibujo de ensamblaje de PCBA.

4.4 Procedimientos de prueba.

4.5 Cualquier restricción mecánica, como los requisitos de altura de montaje.

5. ¿Cuál es el flujo de proceso típico para PCB multicapa?

Corte de material → Película seca interna → Grabado interno → AOI interno → Multi-bond → Capa apilada Presionando → Perforación → PTH → Revestimiento de panel → Película seca externa → Revestimiento de patrón → Grabado externo → AOI externo → Máscara de soldadura → Marca de componente → Acabado de superficie → Enrutamiento → E / T → Inspección visual.

6. ¿Cuáles son los equipos clave para la fabricación de HDI?

La lista de equipos clave es la siguiente: máquina de perforación láser, máquina de prensado, línea VCP, máquina de exposición automática, LDI, etc.

Los equipos que tenemos son los mejores de la industria, las máquinas de perforación láser son de Mitsubishi y Hitachi, las máquinas LDI son de Screen (Japón), las máquinas de exposición automática también son de Hitachi, todas ellas hacen que podamos cumplir con los requisitos técnicos del cliente.

7. ¿Cuántos tipos de acabado superficial O-plomo puede hacer?

O-the leader tiene la serie completa de acabados superficiales, tales como: ENIG, OSP, LF-HASL, baño de oro (suave / duro), plata de inmersión, estaño, baño de plata, baño de estaño de inmersión, tinta de carbón, etc. OSP, ENIG, OSP + ENIG de uso común en el HDI, por lo general, recomendamos que utilice un cliente o OSP OSP + ENIG si el tamaño del PAD BGA es inferior a 0,3 mm.

8. ¿Cuál es su capacidad para FPC? ¿O-Leading también puede proporcionar el servicio SMT?

O-Leading puede fabricar FPC de una sola capa a 8 capas, el tamaño del panel de trabajo puede ser tan grande como 2000 mm * 240 mm, encuentre los detalles en la página "Capacidad flexible"

También brindamos servicio SMT one stop al cliente.

9. ¿Cuáles son los principales factores que afectarán el precio de los PCB?

Material;

Acabado de la superficie;

Dificultad tecnológica;

Diferentes criterios de calidad;

Características de PCB;

Términos de pago;

Diferentes países fabricantes.

10. ¿Cuál es la definición de PCB, PWB y FPC y cuál es la diferencia?

PCB es la abreviatura de placa de circuito impreso;

PWB es la abreviatura de Printed Wire Board, el mismo significado que Printed Circuit Board;

FPC es la abreviatura de tablero impreso flexible.

11. ¿Qué factores deben considerarse al elegir el material para una placa PCB?

Los siguientes factores deben ser considerados cuando elegimos el material para PCB:

El valor Tg del material debe ser mayor que la temperatura de operación;

El material de bajo CTE tiene un buen rendimiento de estabilidad térmica;

Buen rendimiento de resistencia térmica: normalmente se requieren PCB para resistir 250 °C durante al menos 50 s.

Buena planitud; En consideración de las propiedades eléctricas, se utiliza material de baja pérdida / alta permitividad en PCB de alta frecuencia; Substrato de fibra de vidrio de poliimida utilizado para PCB flexible; El núcleo de metal se usa cuando el producto tiene un requisito estricto de disipación de calor.

12. ¿Cuáles son los méritos de la PCB rígida flexible de O-Leading?

El PCB rígido-flexible de O-Leading tiene los caracteres de FPC y PCB, por lo que puede usarse en algunos productos especiales. Una parte es flexible mientras que la otra es rígida, puede ayudar a ahorrar espacio interior del producto, reducir el volumen del producto y mejorar el rendimiento.

13. ¿Cómo hacer el cálculo de impedancia?

El sistema de control de impedancia se realiza utilizando algunos cupones de prueba, el SI6000 soft y el equipo CITS 500s de POLAR INSTRUMENTS.

El equipo mide la impedancia en un cupón de configuración de pista representativo del cual el cliente nos ha dado un determinado valor y tolerancia.